

5G社会に貢献する

 **メック株式会社**

東証プライム市場 4971

2024年3月23日（土）



2024年株主様向け説明会

本日の内容

- 業績について
- メックについて
- 今後の動向について

2023年12月期 総括

事業環境

2023年度はパソコンやスマートフォン、ディスプレイ、タブレットPC等、在庫調整は一巡したものの、弱い個人消費を背景に電子機器需要は低調。2022年Q3まで堅調だったデータセンターも、限られた予算のなか、従来分野よりも先端分野への投資が優先された。

決算概況

前期比 減収減益

事業環境の影響を受け減収減益。2023年Q1を底に回復基調で推移したもののその度合いは緩慢。

主要製品概況

CZ : 関連する電子機器の需要弱く減少。

V-Bond : 自動車の生産に回復の傾向は見られるものの、スマートフォンの影響を受け減少。

EXE : 関連する電子機器の在庫調整一巡し微増。

SF : 関連する電子機器の需要弱く減少。

2023年12月期 業績概要

(単位：百万円)

項目	FY2022 (実績)	FY2023		
		(実績)	前期比	
売上高	16,329	14,020	△ 2,309	△14.1%
薬品売上高	16,042	13,764	△ 2,277	△14.2%
営業利益	4,004	2,492	△ 1,511	△37.7%
営業利益率	24.5%	17.8%	△6.7ppt	-
経常利益	4,246	2,683	△ 1,563	△36.8%
経常利益率	26.0%	19.1%	△6.9ppt	-
当期純利益	3,064	2,304	△ 759	△24.8%
1株当たり当期利益 (円)	161.22	122.29	-	-

2024年12月期 連結業績予想

	FY2024					
	中間			通期		
	百万円	利益率 (%)	増減率 (%)	百万円	利益率 (%)	増減率 (%)
売上高	7,850	-	26.6	16,300	-	16.3
営業利益	1,300	16.6	55.0	3,000	18.4	20.3
経常利益	1,350	17.2	34.6	3,100	19.0	15.5
純利益	950	12.1	△11.7	2,150	13.2	△6.7
1株当たり純利益 (円)	50.73	-	-	114.82	-	-

前期（2023年12月期）は、上期に西宮工場土地建物譲渡による特別利益（549百万円）が計上されております。

会社概要

(2023年12月31日現在)

社名	メック株式会社 MEC COMPANY LTD. M achinery/機械 E lectronics/電子 C hemistry/化学
本社所在地	兵庫県尼崎市杭瀬南新町3丁目4番1号
設立年月日	1969（昭和44）年5月1日
主な業務内容	電子基板・部品製造用薬品の開発・製造販売 及び 機械装置、各種資材の販売
代表者	代表取締役社長 前田 和夫
資本金	5億9,414万2,400円
連結売上高	140億20百万円
上場市場	東証プライム市場（4971,化学）
従業員数	連結454名、単体263名



株主構成（所有株式数）

	2022.6	%	2022.12	%	2023.6	%	2023.12	%
個人	5,705,803	28.4	7,411,266	36.9	5,139,472	25.6	5,551,958	27.7
金融機関	7,028,129	35.0	6,052,129	30.2	7,682,329	38.3	6,466,029	32.2
国内法人	1,625,306	8.1	1,642,663	8.2	1,633,196	8.1	1,605,916	8.0
外国人	4,163,540	20.7	3,736,113	18.6	3,807,883	19.0	4,841,354	24.1
証券会社	652,542	3.3	333,107	1.7	626,371	3.1	423,924	2.1

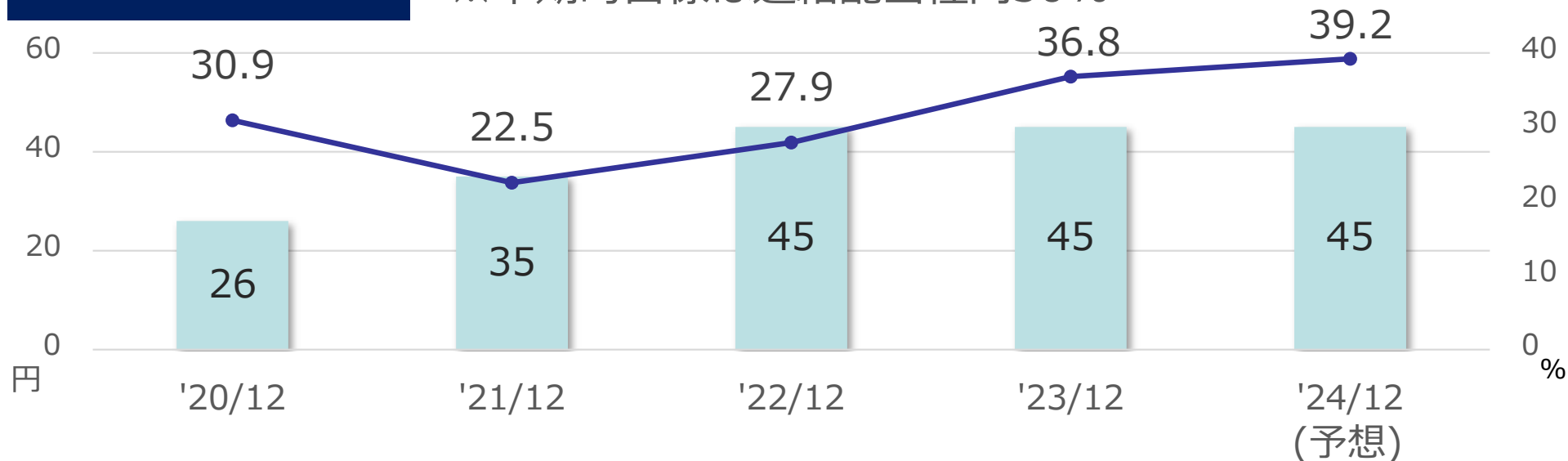
*%は小数点第2位を四捨五入しています

*自己名義株式は含みません

株式と株主還元

配当金推移

※中期的目標は連結配当性向30%



自己株式の取得

- 2023年 6月 286,000株
- 2018年12月 200,000株
- 2017年 3月 200,000株
- 2016年 3月 140,000株
- 2015年11月 500,000株
- 2009年 2月 300,000株

株主優待

- 100株以上 QUOカード1,000円
 - 1,000株以上 QUOカード2,000円
- ※毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式100株（1単元）以上保有の株主様が対象



仕事を楽しむ

『 独創の技術 』






『 信頼の品質 』

『 万全のサービス 』

わたしたちは

「独創の技術」「信頼の品質」「万全のサービス」を信条に、自由に着想し、グローバルな事業活動を通して界面価値創造を実現することで豊かで潤いのある社会と環境づくりに貢献します。

メックとは

-  電子基板・部品製造時に使用される“**薬品**”を開発、製造販売
-  主として金属（特に銅）を溶かす薬品で、銅を溶かしさまざまな付加価値を高める
-  半導体後工程部材である半導体を搭載する「有機パッケージ基板」の銅を溶かす工程において独占的シェア
-  研究開発型企业であり、連結売上高の約10%を研究開発に投資し、研究開発人員は単体従業員の1/3
-  世界中どの生産拠点でも同品質の製品を提供できる生産体制を持つ

 **基板メーカーではなく、めっき用薬品の製造もしていない** 

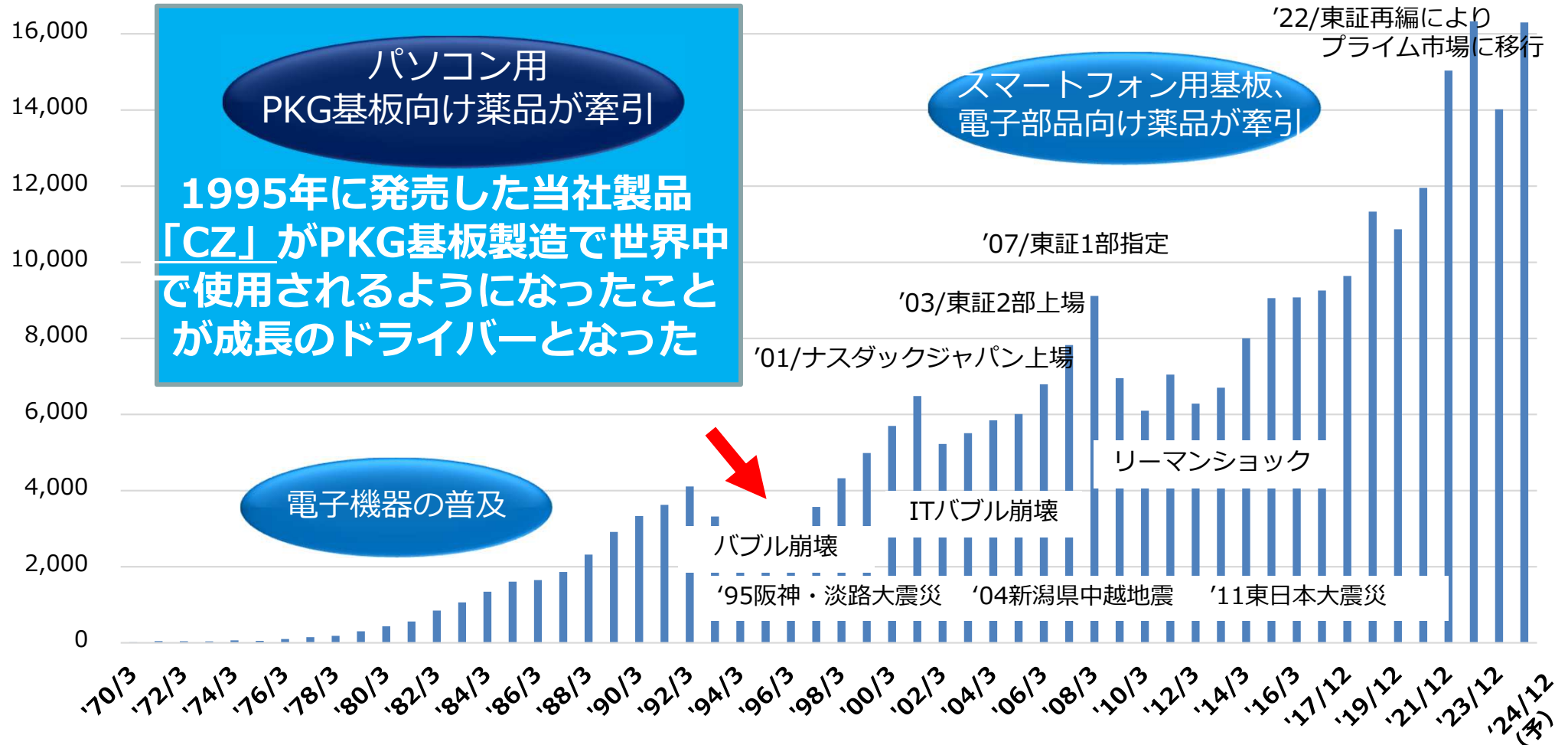
創業からあゆみ

1969/5 大阪市北区に化学技術コンサルタント会社としてスタート

1970/2 電子基板用薬品製造に着手

(百万円)
18,000

5G/IoT/AI/
自動運転/DX/GX



拠点

● 海外子会社

🏠 工場



1992年設立
メックヨーロッパ
【ベルギー】



2001年設立
メック蘇州



2002年設立
メック珠海



2017年設立
メックタイ



1990年設立
メック台湾



● 本社・尼崎事業所
(研究所・工場併設)
兵庫県尼崎市
2017年～



● 本社・東初島事業所
(研究所併設)
兵庫県尼崎市
2020年～



● 東京営業所
東京都立川市
1974年～

● 長岡工場
新潟県長岡市
1993年～

MEC (日本)



北九州工場 (仮称)
2025年稼働予定

メック製品の流れ

決定された開発テーマ、仕様に基づき、
結果が得られるまで徹底的に実験



研究開発から**配合表**



混ぜる

研究開発から出てきた
配合表をもとに薬品を製造

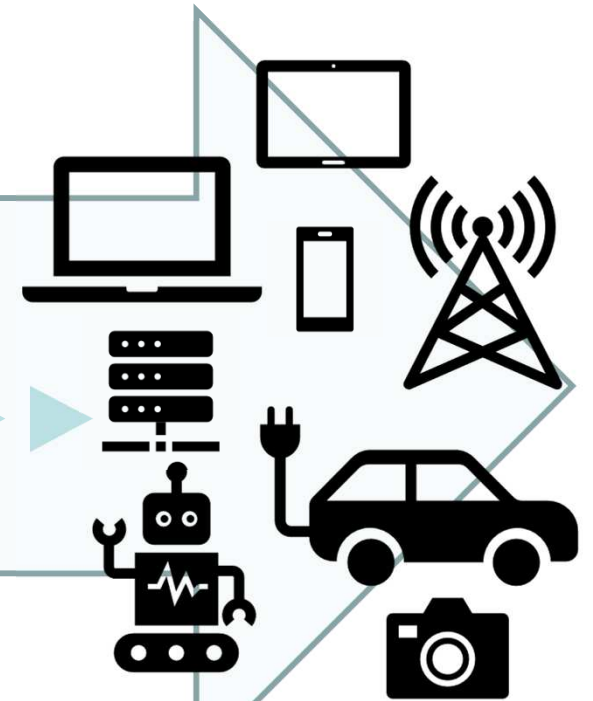
MEC工場で製品を生産



荷姿



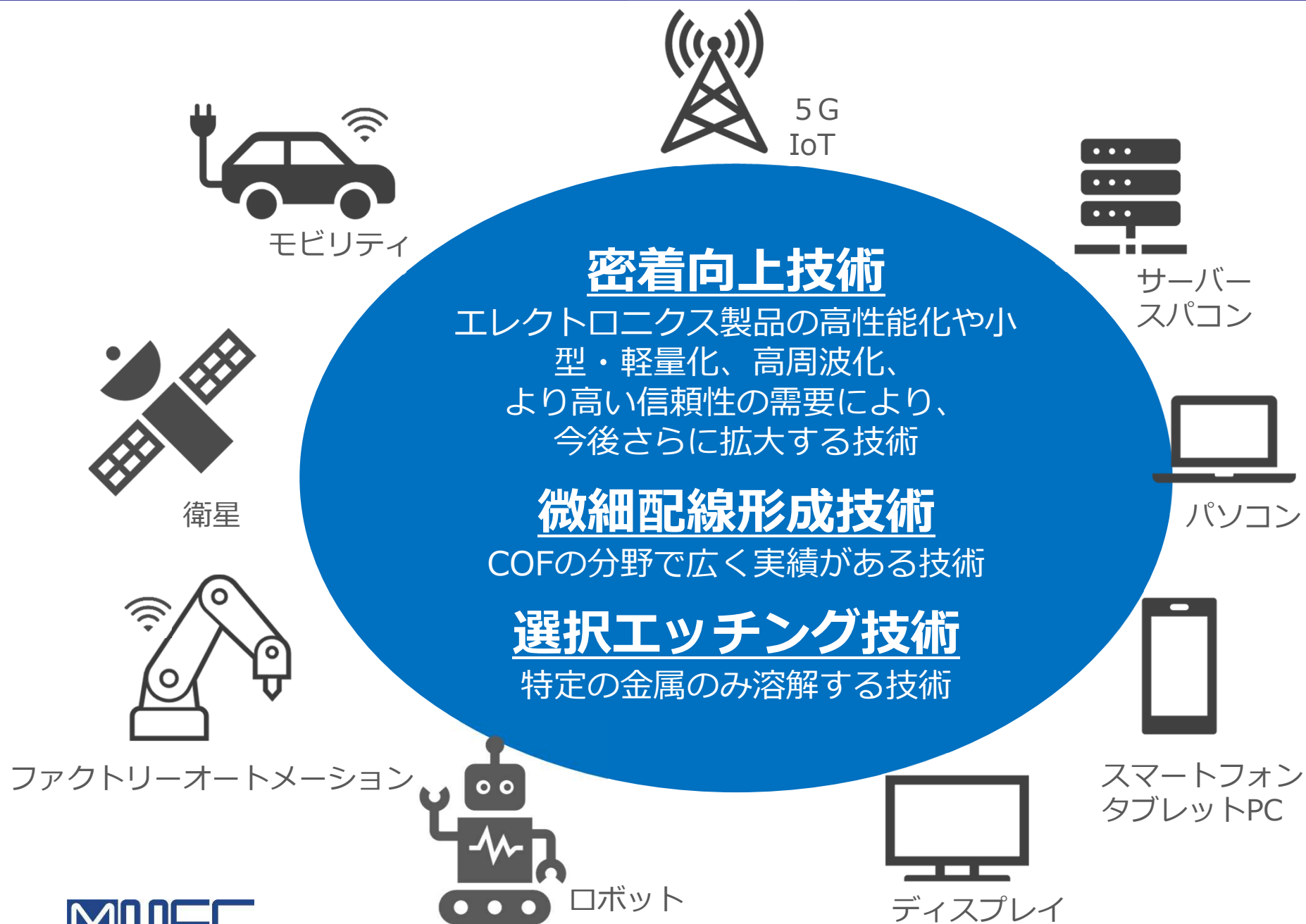
基板メーカー
部品メーカー



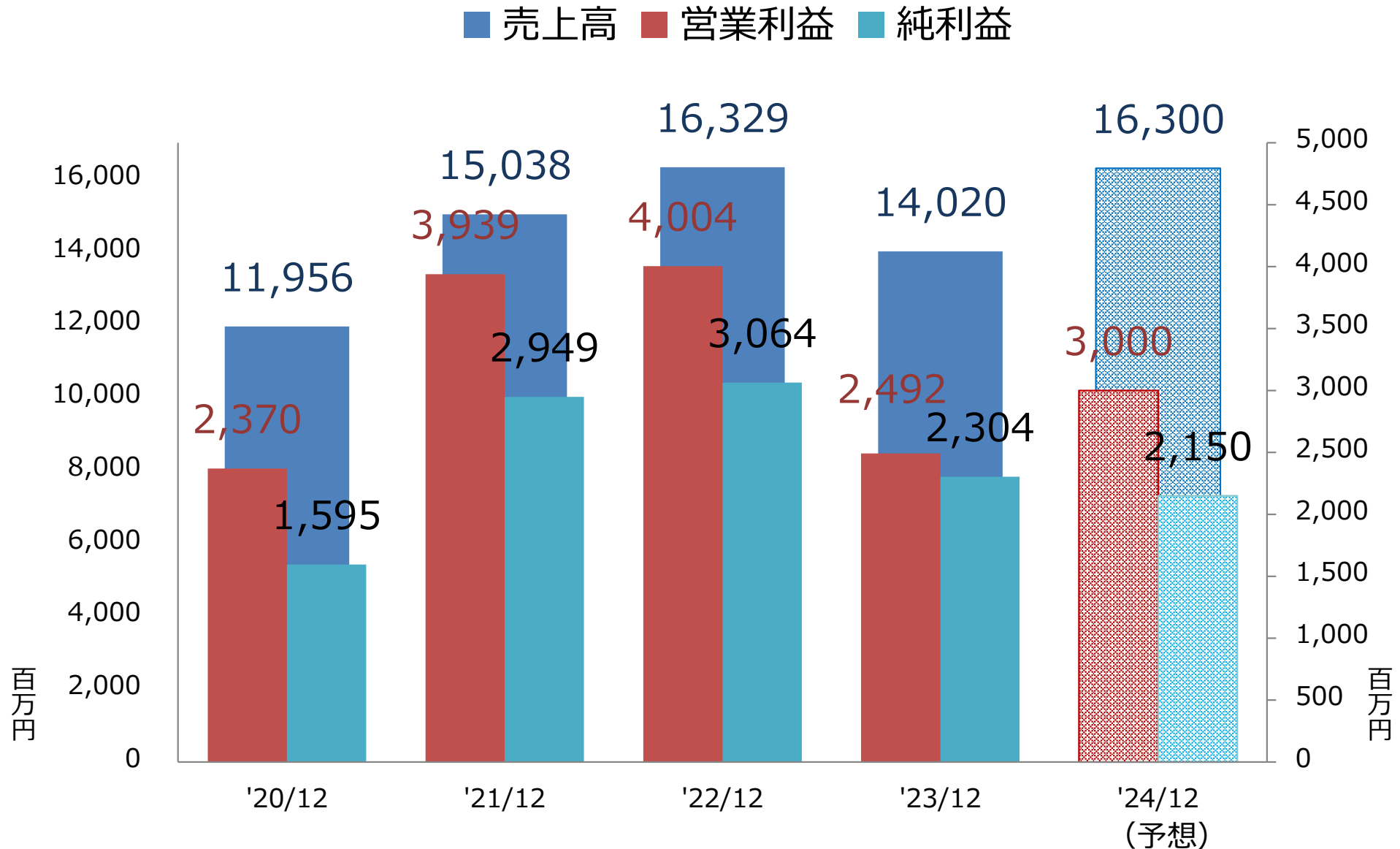
販売店から
皆さまのもとに



メックが活躍できる分野

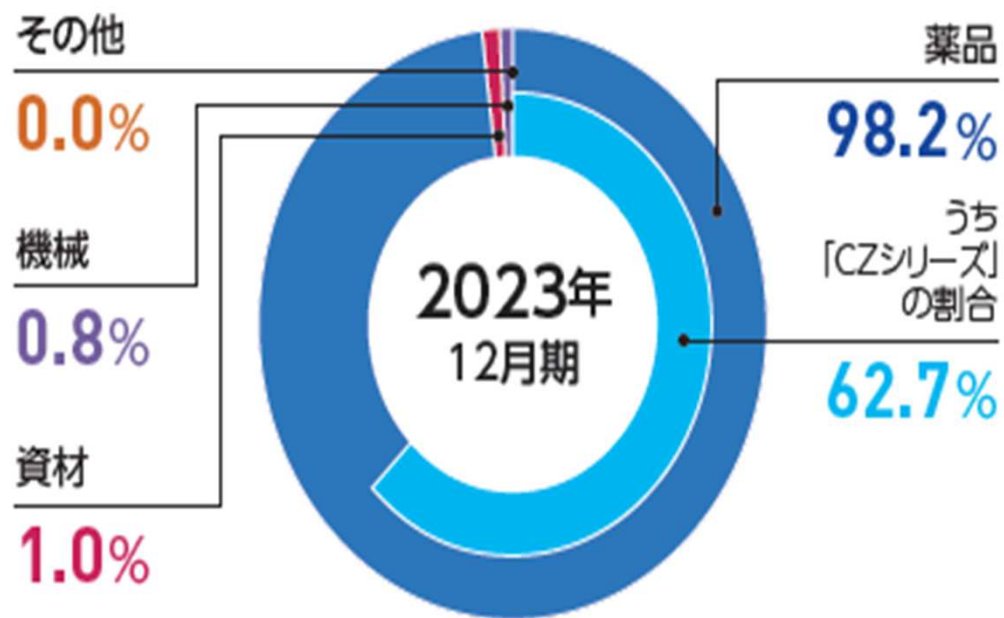


連結通期業績推移

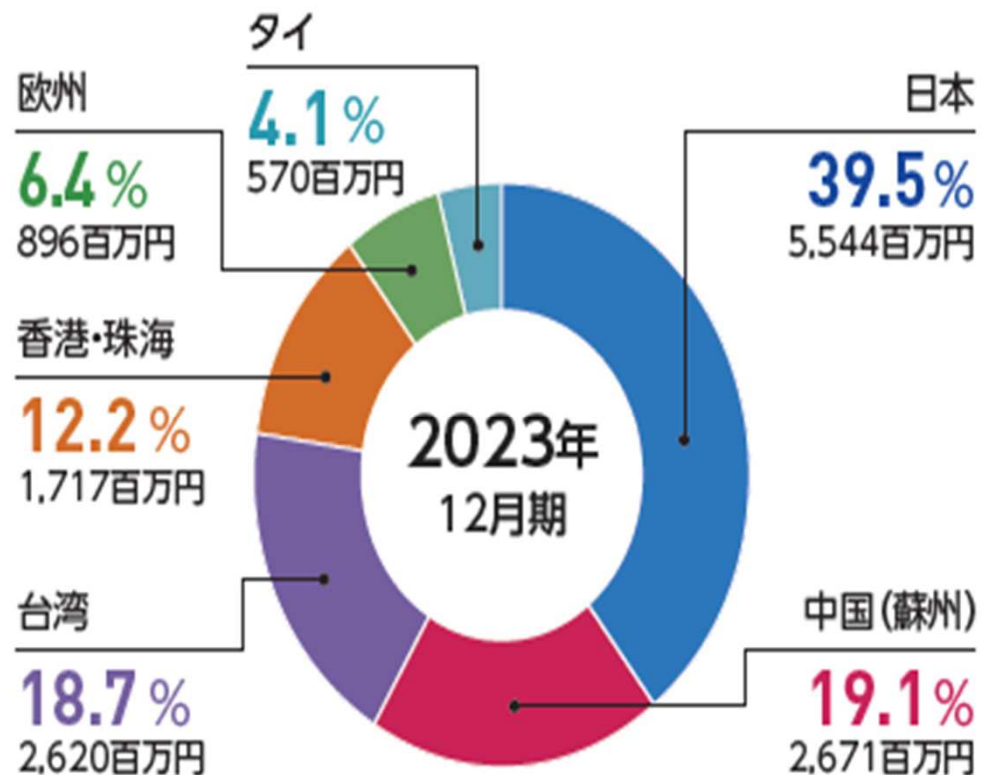


売上構成

売上高に占める品目別割合



地域セグメント別売上高と比率



成長のキーワードと売上拡大のステップ

5G

- 通信方法の世代

IoT・AI

- あらゆるものがネットでつながり
情報処理に人工知能を応用

くるま

- 運転アシストシステム
- 電気自動車

世界的な
半導体需要の増加

半導体メーカーの
巨額な投資

PKGメーカーの
大きな投資

メックの売上拡大

新拠点について

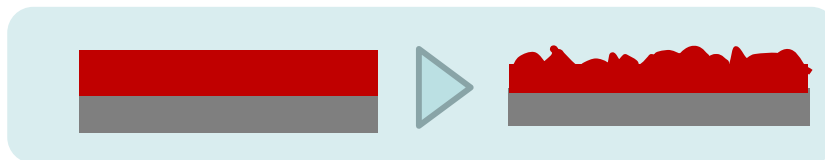


所在地	福岡県北九州市若松区向洋町 10 番
敷地面積	29,889 m ²
着工時期	2024 年 4 月 (予定)
総投資額	約 40 億円 (土地取得費含む)
投資計画	自己資金および負債調達による充当 (予定)
生産能力	約 30,000t/年 (予定)
新規雇用従業員数	10~20 名 (予定)
稼働開始時期	2025 年 7 月 (予定)

界面価値創造

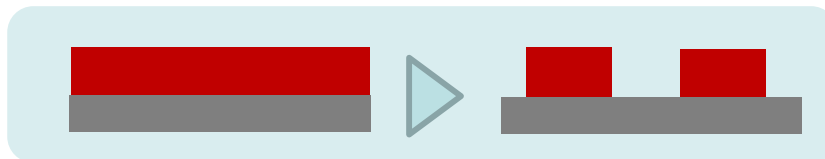
- 表面を粗化し、
機械的に密着性を向上

CZ、V-Bond



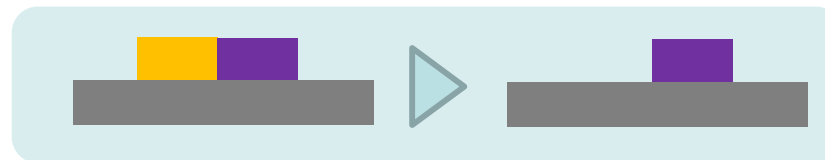
- 配線を形成する

EXE

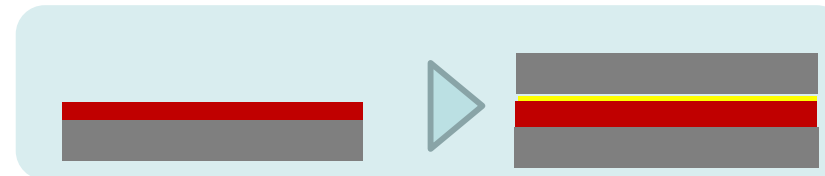


- 選択エッチング

SF



- 表面を処理し、
化学的に密着性を向上



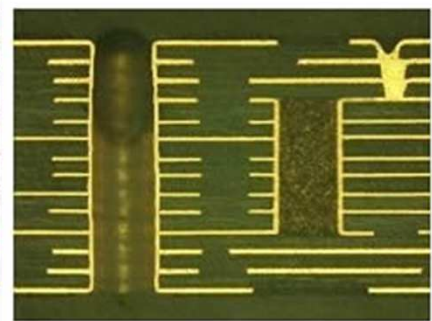
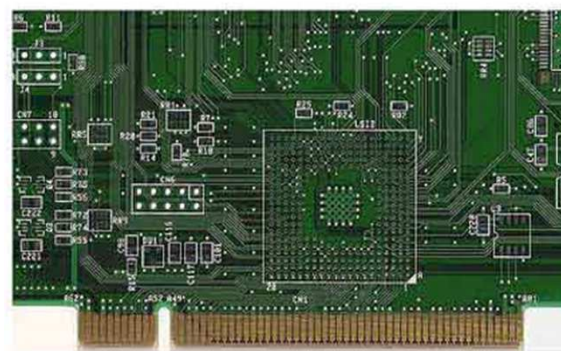
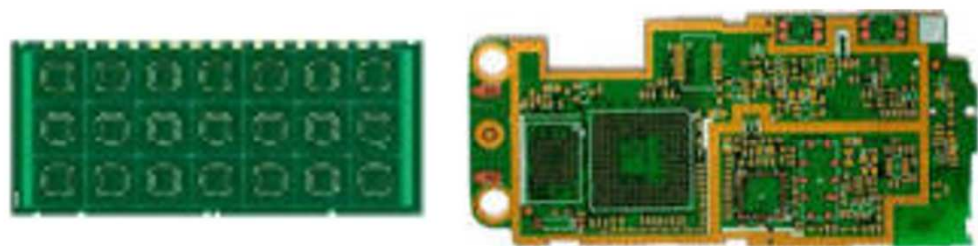
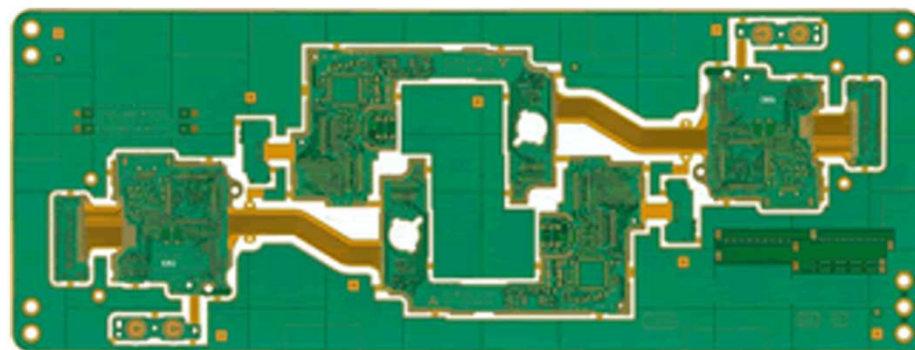
主要薬品用途と最終製品例

主要薬品	特徴	最終製品例
超粗化系密着向上剤 「CZシリーズ」	主にPKG基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。	5G関連・データセンター等のインフラ、パソコン・スマートフォン・タブレットPC等の高機能デバイス等多岐にわたる
多層電子基板向け密着向上剤 「V-Bondシリーズ」	多層基板向けの密着向上剤。 銅と樹脂との密着性を高める銅表面処理剤。PKGには使用されない。	クルマ・スマートフォン等
異方性エッチング 「EXEシリーズ」	サブトラで微細配線形成ができる。 主にCOF基板向けのエッチング剤で使用されている。	テレビ・パソコンのモニター等
選択エッチング銅除去剤 「SFシリーズ」	銅への選択性を持ったエッチング剤。	タブレットPC等

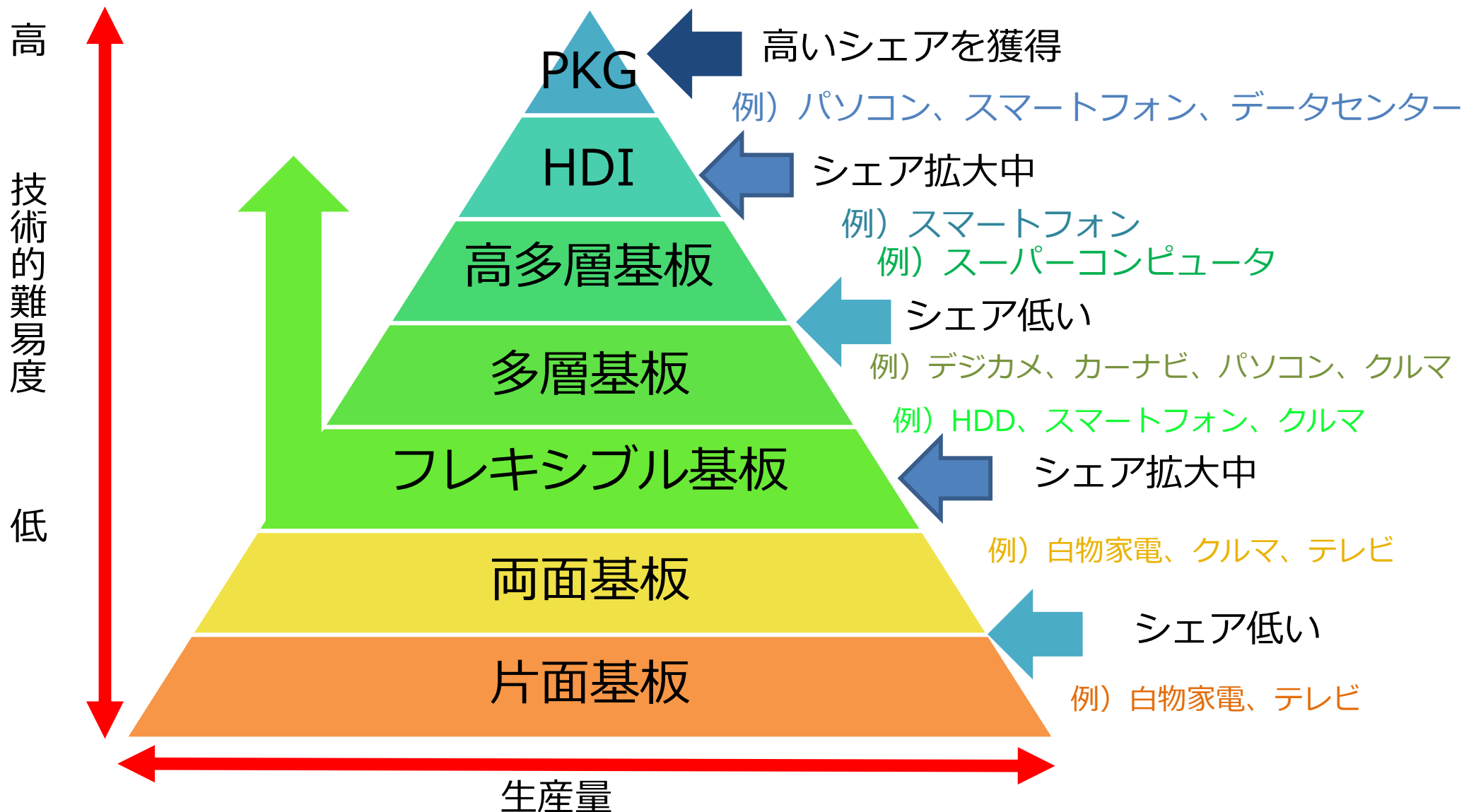
電子基板とは

電子基板は、
家電、通信機器、医療機器
から飛行機や自動車、
産業機器まであらゆる分野で
使用されています。

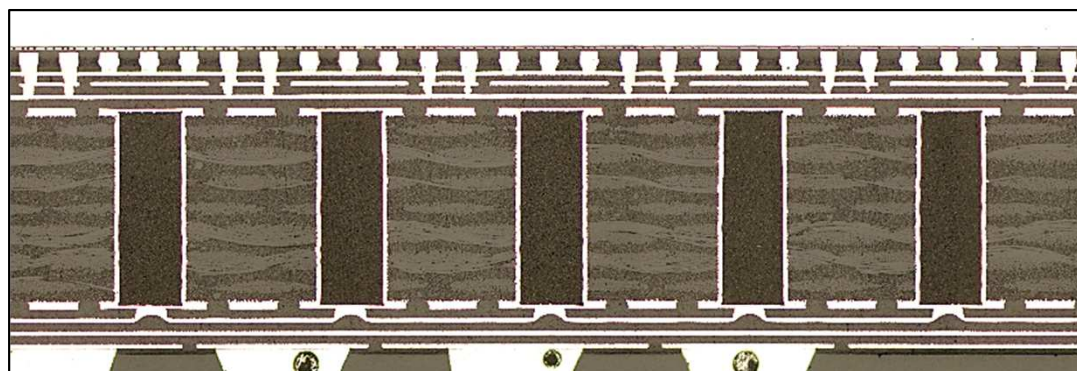
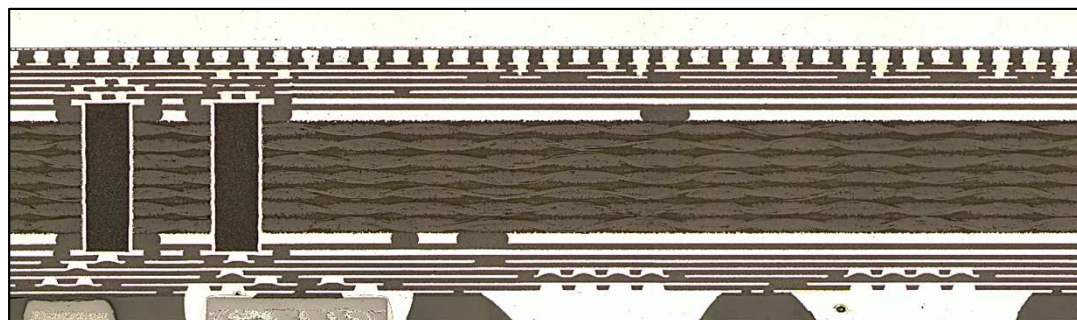
メックは、
私達の暮らしに欠かせない
電子基板の製造の過程で
使用する薬品・機械を開発し、
皆様にお届けしています。



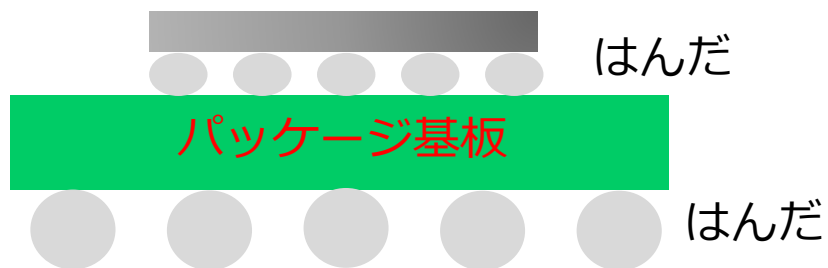
メックが強い領域



パッケージ (PKG) 基板



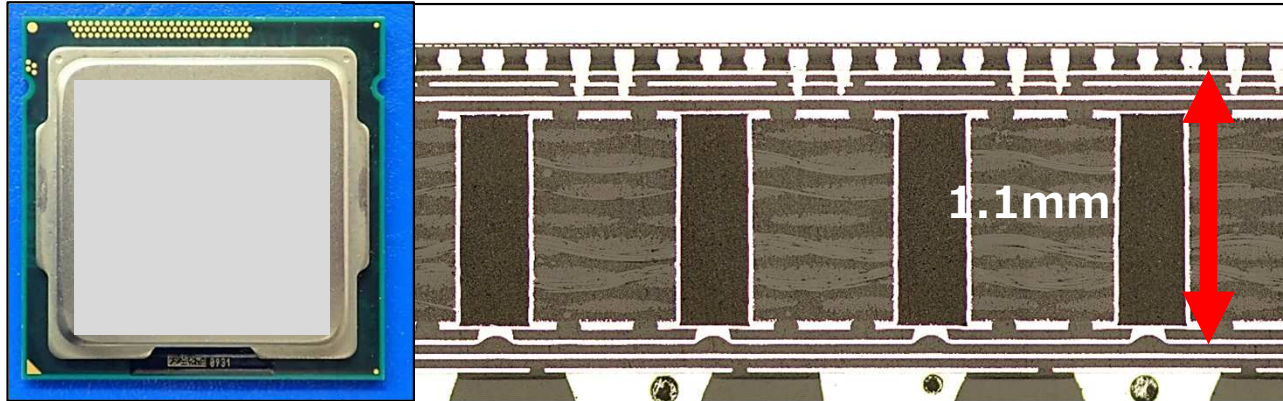
半導体



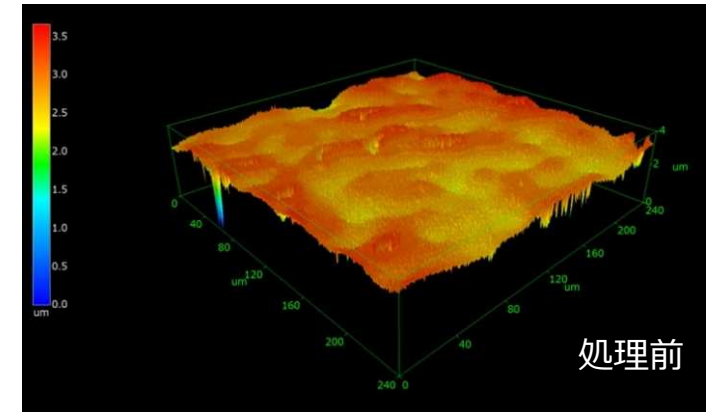
半導体PKG基板の断面イメージ

半導体はnmルール
電子基板は μm ルール
 $1\text{mm} = 1,000\mu\text{m}$
 $1\text{mm} = 1,000,000\text{nm}$

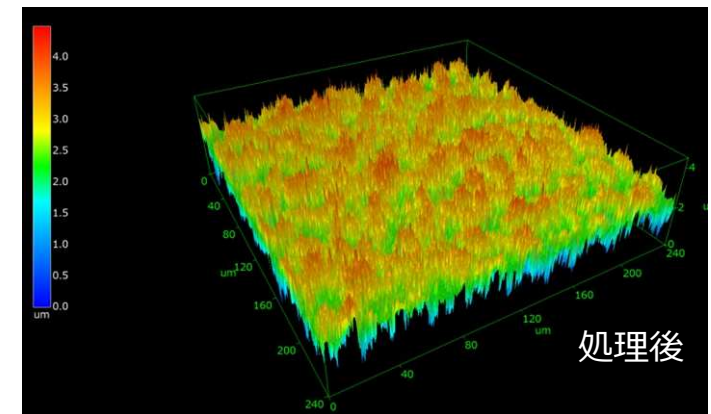
PKG基板とCZ



(10円硬貨の厚みは1.5mm)



処理前

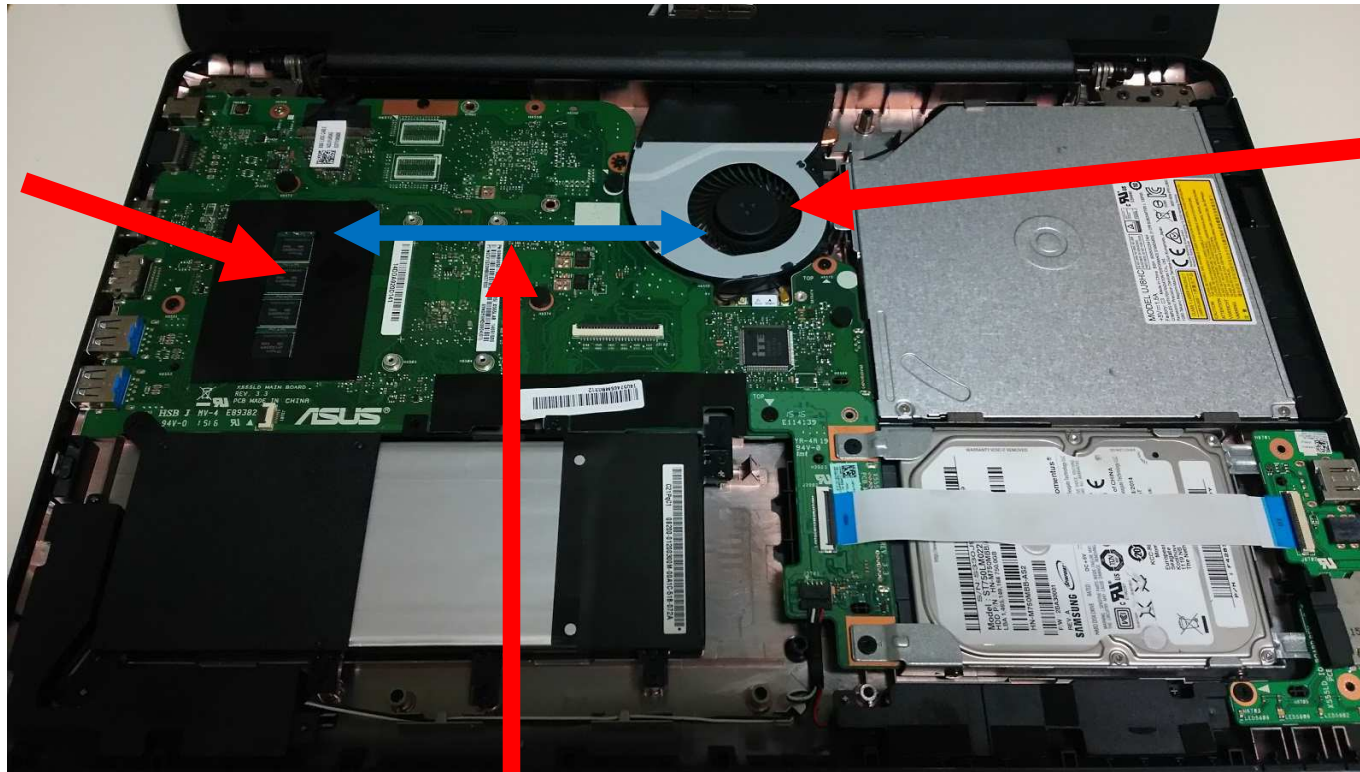


処理後

- **PKG基板**は半導体を搭載するために必要
- 白い部分は銅配線、暗い部分は絶縁樹脂
主に銅の部分に当社の「CZシリーズ」が使用される
- CZ処理で銅表面を微細な凹凸形状にし、銅と樹脂との密着性を大幅に向上させ剥がれない！！
(銅と樹脂の剥がれはエラーに)

コンピューターの中身

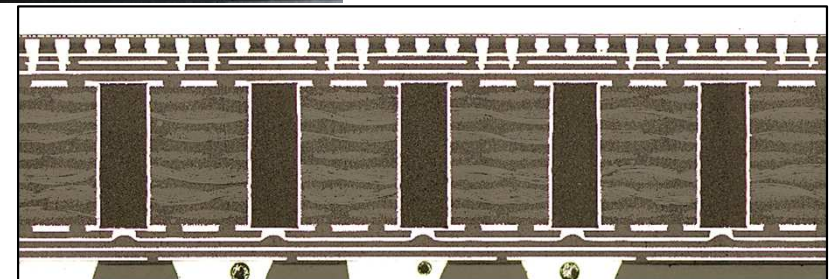
メモリ



冷却ファン下に
CPUを搭載した
PKG



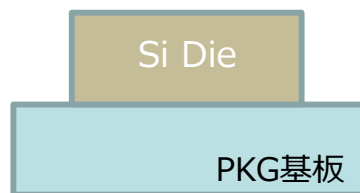
この距離が処理を遅くする



PKGの断面写真

PKG基板の進化

通常のPKG



一つのPKGに
一つの半導体



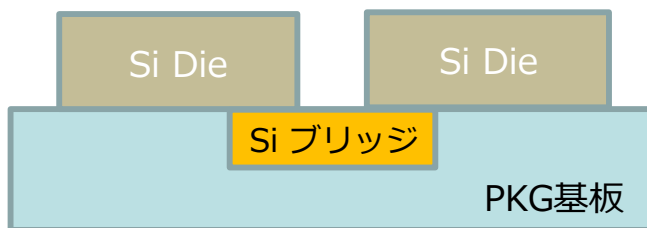
Chiplet



PKGを大きくし
複数の半導体を搭載

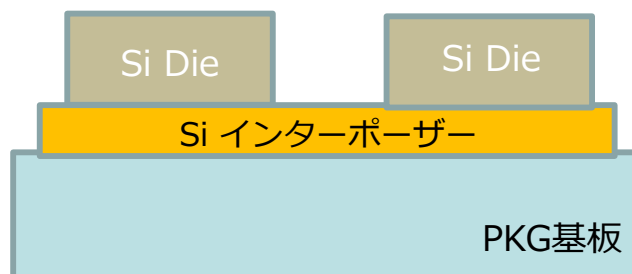
EMIB

(Embedded Multi-die Interconnect Bridge)



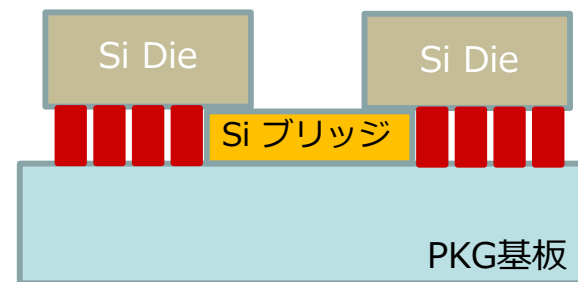
CoWoS

(Chip on Wafer on Substrate)



EFB

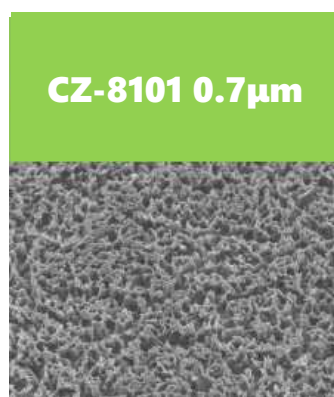
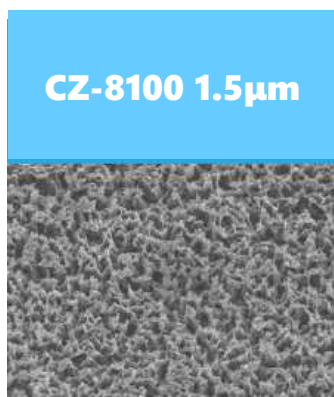
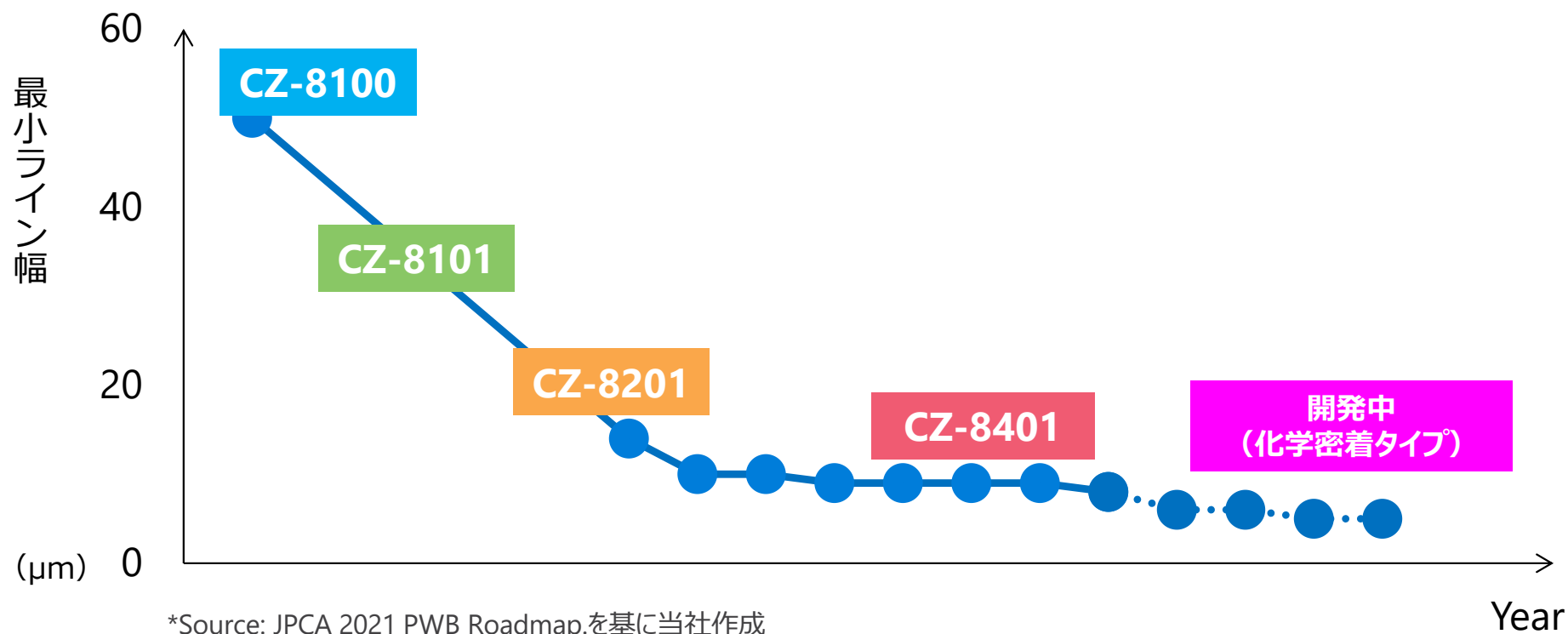
(Elevated Fanout Bridge)



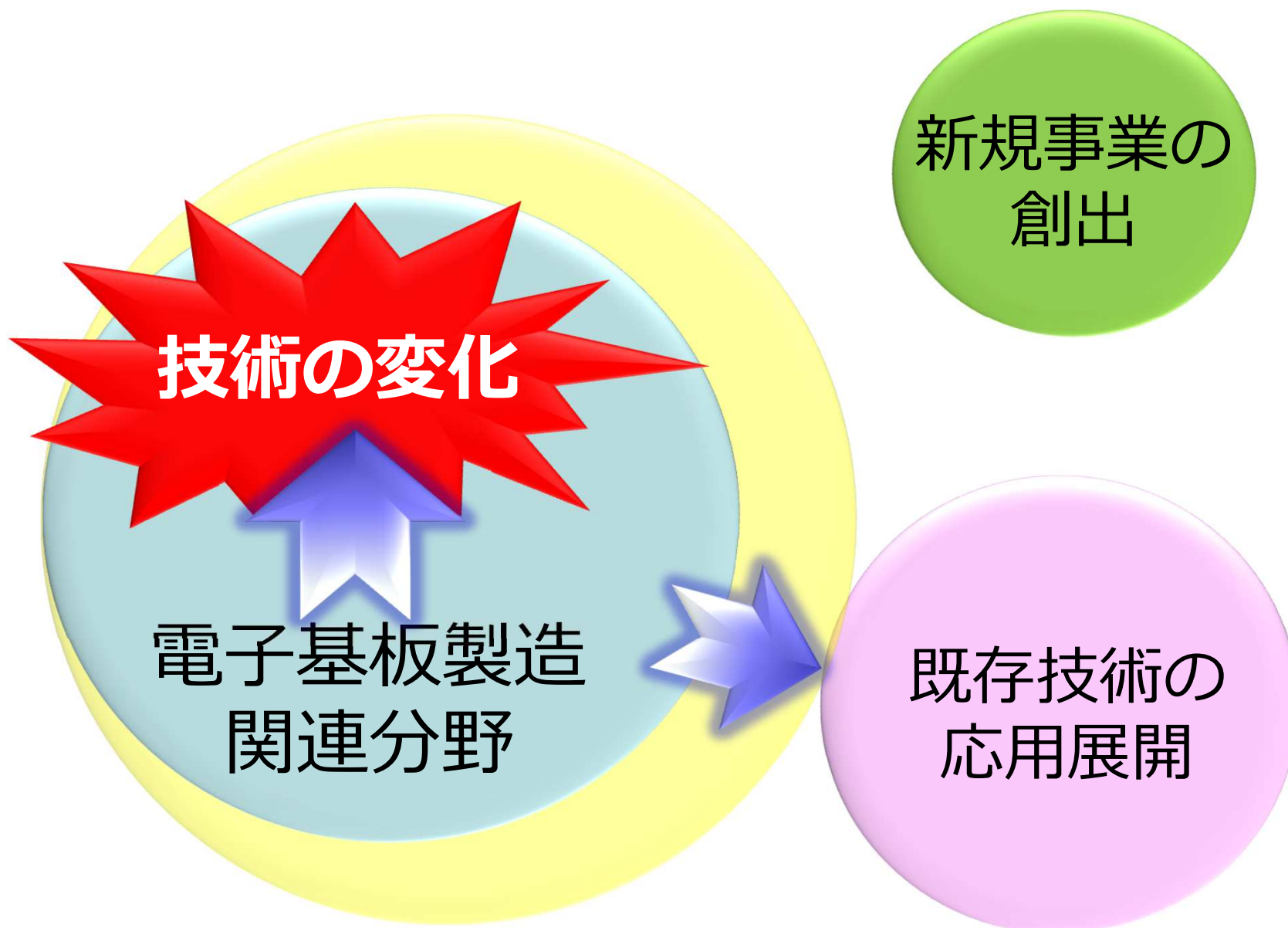
■ 銅ピラー

PKG基板 ⇒ サイズ大型化、層数増加

CZシリーズのロードマップ



事業領域の拡大を目指して



2030年ビジョン

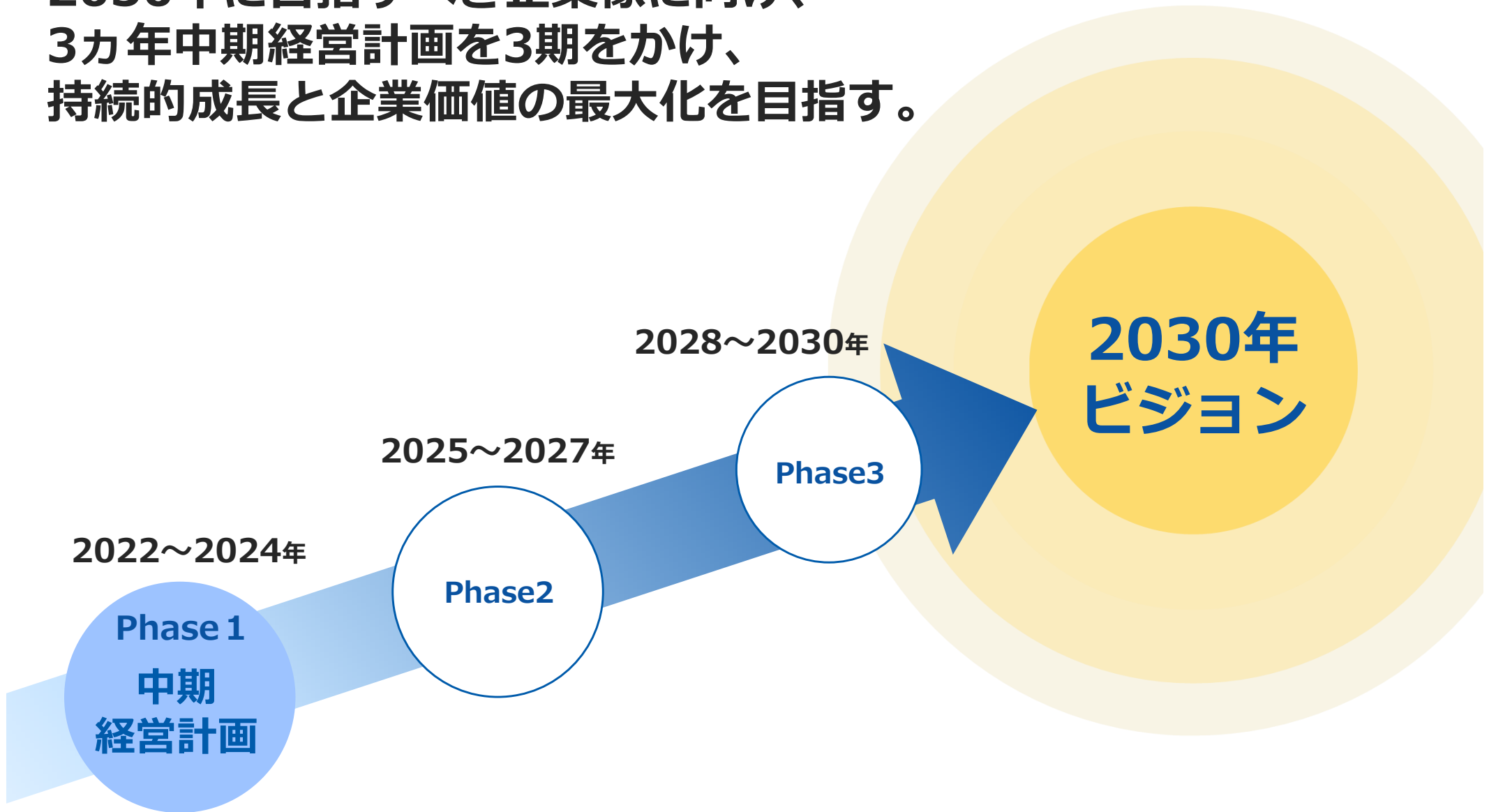
Phase 1

中期経営計画

(2022-2024)

2022年2月14日

2030年に目指すべき企業像に向け、
3カ年中期経営計画を3期をかけ、
持続的成長と企業価値の最大化を目指す。





**独創の技術で新たな価値を創造する
真のグローバルカンパニーになる**



研究開発型企业であり続ける



独創のAI企業としての顔をもつ

2024年数値目標（連結）

営業利益率

20%以上

ROE

10%以上

ご清聴ありがとうございました

このプレゼンテーション資料には、2024年3月23日現在の将来に関する予測が含まれております。記述している将来予測および業績予測は、当社が現時点で入手できる情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、さまざまな要因の変化により、実際の業績は記述している将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知ください。



<https://www.mec-co.com/>

当社のホームページでは「プレスリリース」、「株主通信」、「サステナビリティ報告書」、「コーポレート・ガバナンス報告書」他、各種情報を掲載しています。ぜひご覧ください

